



タッチパネル用 フォトタイプ導電性銀ペースト EPH[®]-300 シリーズ Photolithographic Conductive Silver Paste for TSP

静電容量タッチパネル用回路技術動向

Technical Trend for Projected Capacitance Touch Screen Panel

- 狭額縁化による線幅の狭小化 Finer L/S on narrower space
- パネルの巨大化に伴う配線距離の延長 Longer electrodes for wider panel size



スクリーン印刷の限界 : L/S=50/50um
Process Limitation of Screen Printing Method L/S=50/50



スパッターエッチング或いはフォトリソグラフィーによる配線形成へ移行
Move to Sputter Etching Method or Photolithographic Method

静電容量タッチパネル電極形成方法比較

Comparison of Electrode Patterning Methods

スクリーン印刷法 Screen Printing

基材
Base material
↓
パターン印刷
Pattern printing
↓
乾燥・熱処理
Thermal process

スパッターエッチング法 Sputter Etching

基材
Base material
↓
Mo スパッタ
Mo Sputter
↓
Al スパッタ
Al Sputter
↓
Mo スパッタ
Mo Sputter
↓
エッチングレジスト塗布
Etching Resist printing
↓
乾燥
Drying
↓
露光
Exposure
↓
エッチングレジスト現像
Development of Etching Resist
↓
金属エッチング
Metal etching
↓
エッチングレジスト剥離
Removal of Etching Resist

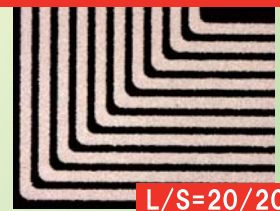
新提案
New Proposal

フォトリソグラフィ法 Photolithography

基材
Base material
↓
ベタ印刷
Printing without Patterning
↓
乾燥
Drying
↓
露光
Exposure
↓
現像
Development
↓
熱処理
Thermal process

現在の配線
形成方法
Conventional method

熱処理温度 : 130deg.C
比抵抗値 : 5.0E-05 Ω · cm



L/S=20/20um



TAIYO INK MFG. CO., LTD.